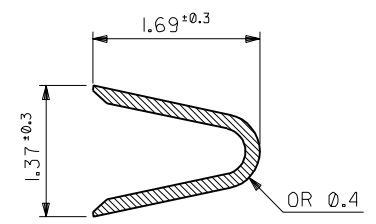


SECT. Z-Z



SECT. Y-Y

注記
NOTES

- 適合ハウジング：51022シリーズ
APPLICABLE HOUSING：51022 SERIES
- メッキ仕様 PLATING
錫 0.9μm MIN. リフロー処理（前メッキ）
TIN 0.9μm MIN. REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
C	変更 REVISD (J30697)	H.H. M.F.	93/7/10
B	変更&再作図 REVISD & REDRAWN (J20810)	H.H. M.F.	92/10/27

材料 MATERIAL	リン青銅 PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
仕上げ FINISH	—H—
適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG #26-28
被覆外径 INS. RANGE	Ø 0.5-1.0
DRAWN BY	92/10/27 H.HIRAMOTO
CHK'D BY	93/7/10 H.HIRAMOTO
APP'D BY	93/7/10 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE	20 - 1

50080-8100	バラ状 LOOSE
50080-8000	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 1.25 BOARD IN CRIMP TERMINAL	
DWG. NO.	REV
SD-50080-8*00	C